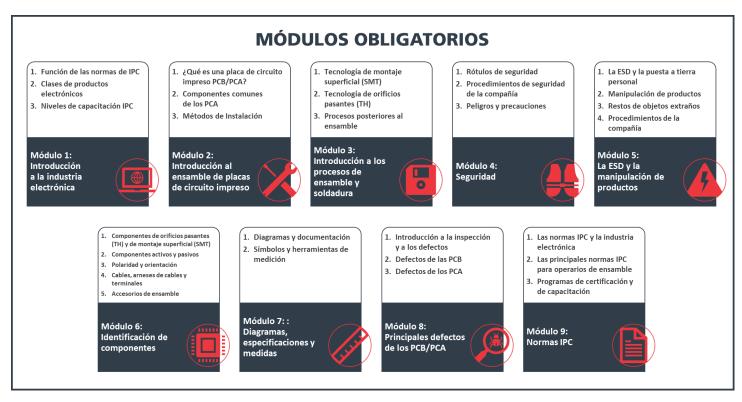
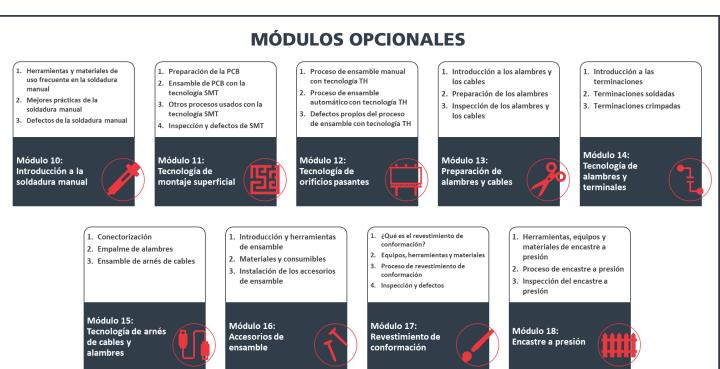
Ensamble de Electrónica para Operarios Plan de Estudios y Guía para Instructores





MÓDULOS OBLIGATORIOS

Módulo 1: Introducción a la industria electrónica

SECCIONES

- 1. La función de las normas de IPC
- 2. Las clases de productos electrónicos
- 3. Los niveles de capacitación IPC

Módulo 2: Introducción al ensamble de placas de circuito impreso

SECCIONES

- 1. ¿Qué es una placa de circuito impreso PCB/PCA?
- 2. Componentes comunes de los PCA
- 3. Métodos de Instalación

Módulo 3: Introducción a los procesos de ensamble y soldadura

SECCIONES

- 1. Tecnología de montaje superficial (SMT)
- 2. Tecnología de orificios pasantes (TH)
- 3. Procesos posteriores al ensamble

Módulo 4: Seguridad

SECCIONES

- 1. Rótulos de seguridad
- 2. Procedimientos de seguridad de la compañía
- 3. Peligros y precauciones

Módulo 5: La ESD y la manipulación de productos

SECCIONES

- 1. La ESD y la puesta a tierra personal
- 2. Manipulación de productos
- 3. Restos de objetos extraños (FOD)
- 4. Procedimientos de la compañía

Módulo 6: Identificación de componentes

SECCIONES

- 1. Componentes de orificios pasantes (TH) y de montaje superficial (SMT)
- 2. Componentes activos y pasivos
- 3. Polaridad y orientación
- 4. Cables, arneses de cables y terminales
- 5. Accesorios de ensamble

Módulo 7: Diagramas, especificaciones y medidas

SECCCIONES

- 1. Diagramas y documentación
- 2. Símbolos y herramientas de medición

Módulo 8: Principales defectos de los PCB/PCA

- 1. Introducción a la inspección y a los defectos
- 2. Defectos de las PCB
- 3. Defectos de los PCA

Módulo 9: Normas IPC

SECCIONES

- 1. Las normas IPC y la industria electrónica
- 2. Las principales normas IPC para operarios de ensamble
- 3. Programas de certificación y de capacitación

Examen Final para los Módulos Obligatorios (1-9)

Los estudiantes deben completar el examen final para los módulos del 1 al 9 con una calificación mínima del 80% para descargar su Certificado de Cualificación como Operador de Ensamble IPC. Los estudiantes disponen de hasta tres (3) intentos para aprobar el examen. Tenga presente que el tercer y último intento se permite después de 24 horas del segundo intento.

MÓDULOS OPCIONALES

Módulo 10: Introducción a la soldadura manual

SECCIONES

- 1. Herramientas y materiales de uso frecuente en la soldadura manual
- 2. Mejores prácticas de la soldadura manual
- 3. Defectos de la soldadura manual

Módulo 11: Tecnología de montaje superficial

SECCIONES

- 1. Introducción y preparación de la placa de circuito impreso
- 2. Ensamble de PCB con la tecnología de montaje superficial
- 3. Otros Procesos usados con la tecnología de montaje superficial
- 4. Inspección y defectos de la tecnología de montaje superficial

Módulo 12: Tecnología de orificios pasantes

SECCIONES

- 1. Introducción y proceso de ensamble manual con tecnología de orificios pasantes
- 2. Proceso de ensamble automático con tecnología de orificios pasantes
- 3. Defectos propios del proceso de ensamble con tecnología de orificios pasantes

Módulo 13: Preparación de alambres y cables

SECCIONES

- 1. Introducción a los alambres y los cables
- 2. Preparación de los alambres
- 3. Inspección de los alambres y los cables

Módulo 14: Tecnología de alambres y terminales

- 1. Introducción a las terminaciones
- 2. Terminaciones soldadas
- 3. Terminaciones crimpadas

Módulo 15: Tecnología de arnés de cables y alambres

SECCIONES

- 1. Conectorización
- 2. Empalme de alambres
- 3. Ensamble de arnés de cables

Módulo 16: Accesorios de ensamble

SECCIONES

- 1. Introducción y herramientas de ensamble
- 2. Materiales y consumibles
- 3. Instalación de los accesorios de ensamble

Módulo 17: Revestimiento de conformación

SECCIONES

- 1. ¿Qué es el revestimiento de conformación?
- 2. Equipos, herramientas y materiales
- 3. Proceso de revestimiento de conformación
- 4. Inspección y defectos

Módulo 18: Encastre a presión

- 1. Herramientas, equipos y materiales de encastre a presión
- 2. Proceso de encastre a presión
- 3. Inspección del encastre a presión

Módulo 1: Introducción a la industria electrónica

■ OBJECTIVOS

- Reconocer la función de las normas IPC
- Distinguir los productos electrónicos de clase 1, 2 y 3
- Explicar la diferencia entre los programas de certificación y de capacitación

Materiales de instrucción opcionales

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

SECCIONES

- 1. La función de las normas IPC
- Introducción a la industria electrónica
- Temas cubiertos por las normas IPC
- Beneficios de emplear las normas IPC

PRÁCTICA: ¿POR QUÉ SE APLICAN LAS NORMAS?

- 2. <u>Las clases de productos electrónicos</u>
- Definiciones y ejemplos de productos de clase 1, 2 y 3
- PRÁCTICA: PRODUCTOS DE CLASE 3
- PRÁCTICA: IDENTIFIQUE LA CLASE DEL PRODUCTO
- 3. Los niveles de capacitación IPC
- La diferencia entre la certificación y la capacitación
- Seis de las principales normas IPC
- Los 6 niveles de certificación IPC: CIS, CIT, MIT, CSE, CID/CID+, and CEPM
- PRÁCTICA: NORMAS IPC
- PRÁCTICA: NIVELES DE CERTIFICACIÓN

Módulo 2: Introducción al ensamble de placas de circuito impreso (PCA)

OBJECTIVOS

- Definir las características principales de una placa de circuito impreso (PCB)
- Identificar los componentes comunes de un ensamble de circuito impreso (PCA)
- Describir los diferentes métodos de instalar componentes en una placa de circuito impreso

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN OPCIONALES

- Ejemplos de materiales comunes de PCB y PCA (como disponible):
 - o Placas de SMT, TH, y PTH
 - o PCBs rígidos y flexibles
 - Componentes como capacitores, resistencias, diodos, transistores, terminales, cables, y accesorios de montaje
 - o Soldador
 - Adhesivos como epoxi y resina
 - o Dispositivos de sujeción como tornillos, pernos, y pines de encastre a presión

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

- 1. ¿Qué es una PCB/PCA?
- Visión general de los tipos y partes de una PCB
- PRÁCTICA: TH, PTH, Y SMT ¿CUÁL ES CUÁL?
- 2. Componentes comunes de los PCA
- Descripción de condensadores, resistencias, diodos, transistores, terminales, cables, y accesorios de ensamble
- 3. Métodos de instalación
- Descripción de los métodos de montaje por medio de soldadura, adhesivo, y dispositivos de sujeción mecánica
- <section-header> PRÁCTICA: COMPLETE LA PCA
- PRUEBA DE PRÁCTICA FINAL

Module 3: Introducción a los procesos de ensamble y soldadura

OBJECTIVOS

- Describir el proceso de ensamble con tecnología de montaje superficial (SMT)
- Describir el proceso de ensamble con tecnología de orificios pasantes (TH)
- Comparar los procesos de ensamble con tecnologías de montaje superficial (SMT) y de orificios pasantes (TH)
- Identificar los distintos procesos posteriores del proceso de ensamble electrónico

Materiales de Instrucción Opcionales

- Si es posible, demuestre ejemplos de materiales comunes para las PCB y PCA (como disponible):
 - o Placas de PCB y PCA para SMT, TH y PTH
 - o Pasta de soldadura (con y sin plomo)
 - o Alambre de soldadura (con y sin plomo)
 - Soldador (herramienta)
 - o Productos de limpieza de PCB/PCA como (p. ej. alcohol isopropílico)
 - Herramientas para el preformado de terminales (p. ej. árbol de navidad, bloque, pinzas, alicate de corte)
 - Materiales para el ensamblaje del producto final (p. ej. arneses de cables, fuentes de alimentación, conectores)
 - o PCA con revestimiento de conformación
 - o Adhesivo como epoxi y resina
- Si es posible, demuestre algunas de las máquinas de ensamble en su fábrica:
 - o Impresora de pasta de soldadura
 - o Máquina de recogida y colocación
 - o Máquina de inserción automática
 - Horno de refusión
 - Máquina de soldadura por ola
 - o Máquina de soldadura selectiva
 - o Máquinas de preformado de terminales (semiautomática/automática)
 - Máguinas para limpiar las PCB/PCA
 - o Máquinas de pruebas funcionales y pruebas en circuito (ICT)
 - Máquina de inspección óptica automática (AOI)
 - Máquina de inspección automática por rayos X (AXI)

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

E SECCIONES

1. Tecnología de montaje superficial (SMT)

- Visión general del proceso de ensamble SMT, incluyendo:
 - Preparación de la PCB
 - Serigrafía de la pasta de soldar
 - Colocación de los componentes
 - o Compleción en horno de refusión

PRÁCTICA: PROCESO DE ENSAMBLE SMT

2. Tecnología de orificios pasantes (TH)

- Visión general del proceso de ensamble TH:
 - Preparación de la PCB
 - o Inserción automática de componentes
 - Preformado de terminales (manual y semiautomático)

- o Inserción manual de componentes
- o Soldadura por ola, soldadura selectiva y soldadura manual

PRÁCTICA: PROCESO DE ENSAMBLE TH

3. Procesos posteriores al ensamble

- Visión general de los procesos más comunes en pos del proceso de ensamble:
 - o Limpieza
 - o Pruebas
 - Inspección
 - o Revestimiento de conformación
 - Adhesivo
 - o Ensamblaje del producto final (box build)
- PRÁCTICA: PROCESOS EN POS DEL PROCESO DE ENSAMBLE
- PRUEBA DE PRÁCTICA FINAL

Módulo 4: Seguridad

OBJECTIVOS

- Identificar los rótulos y símbolos de seguridad relevantes para los operadores de ensamble
- Describir los procedimientos de seguridad estándar para proteger a los operarios, al equipo y a los productos de ensamble
- Identificar los peligros y riesgos que presentan los materiales tradicionalmente utilizados por los operarios de montaje
- Describir las consideraciones de seguridad relacionadas con el uso de equipos de ensamble

Materiales de Instrucción Opcionales

Si es posible, demuestre:

- Una copia del Plan de Acción en Caso de Emergencia empleado en su instalación
- Ejemplos de equipo de seguridad:
 - Equipo de protección personal (PPE) como guantes, gafas, protectores faciales, y respiradores
 - o Pulseras, calzados y batas antiestáticas
 - o Extintor de fuego
 - o Fichas de datos de seguridad (SDS)
- Rótulos de seguridad que se emplean en su instalación, como por ejemplo:
 - o Etiquetas de materiales peligrosos
 - Zona de protección contra ESD
 - o Etiquetas de bloqueo/etiquetado
 - o Se requiere protección de ojos
- Estaciones de emergencia en su instalación, como por ejemplo:
 - o Estaciones de lavado de ojos y duchas de emergencia
 - o Primer auxilio
- Ejemplos de materiales communes que pueden ser peligrosos, como por ejemplo:
 - Fundente
 - Alambre de soldadur (con plomo)
 - Alcohol isopropílico (IPA)
 - o Químicos de revestimiento de conformación

🖺 PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

SECCIONES

1. Rótulos de seguridad

- Visión general de los diferentes tipos de rótulos de seguridad
- Propósito de las etiquetas de materiales peligrosos y de bloqueo/etiquetado
- Propósito de los rótulos de área protegida contra descargas electrostáticas (EPA)

PRÁCTICA: TIPOS DE RÓTULOS DE SEGURIDAD

2. Procedimientos de seguridad de la compañía

- Descripción, propósito y ejemplos del equipo de protección personal (PPE)
- Visión general de los procedimientos de seguridad estándar, como los planes de acción en caso de emergencia, seguridad contra incendios, primer auxilio y fichas de datos de seguridad (SDS)
- PRÁCTICA: PROPÓSITO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
- PRÁCTICA: EN CASO DE EMERGENCIA

3. Peligros y precauciones

- Descripción de los peligros relacionados con el fundente, la soldadura con fundente con plomo, productos de limpieza y el revestimiento de conformación.
- PRÁCTICA: FUNDENTE EN LA MENTE
- PRÁCTICA: SEGURIDAD EN LOS PROCESOS
- PRÁCTICA: CONOZCA SU SOLDADURA
- PRÁCTICA: SEGURIDAD DURANTE EL ENSAMBLE DEL PRODUCTO FINAL (BOX BUILD)
- PRUEBA DE PRÁCTICA FINAL

Módulo 5: La ESD y la manipulación de productos

OBJETIVOS

- Identificar la causa y maneras de prevenir la descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés)
- Describir la función de los dispositivos de puesta a tierra personal y control de electricidad estática
- Demostrar los procedimientos correctos de manipulación de PCB y PCA
- Describir la causa y la manera de prevenir los restos de objetos extraños (FOD, por sus siglas en inglés)

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN OPCIONALES

- Copia de los procedimientos relativos a la manipulación de productos y la ESD específicos de la instalación
- Ejemplos de equipos personales de puesta a tierra como pulseras, calzados y batas antiestáticas
- Ejemplos de PCA o componentes dañados por errores como:
 - o Descarga electrostática (ESD)
 - Manipulación incorrecta
 - o Exposición al calor y a la humedad
 - Restos de objetos extraños (FOD)
- Ejemplos de equipos de embalaje, almacenamiento y transporte seguros contra la ESD

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

SECCIONES

- 1. La ESD y la puesta a tierra personal
- Definición y daño por ESD dentro del ensamble electrónico
- PRÁCTICA: LA ESD EN ACCIÓN
- PRÁCTICA: ELEMENTOS DE CONTROL DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA PARA OPERARIOS
- PRÁCTICA: DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LA ESD
- 2. Manipulación de productos
- Descripción general del daño causado por la manipulación y exposición inadecuada del producto
- Descripción de equipos de embalaje, almacenamiento y transporte seguros contra ESD
- PRÁCTICA: EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
- PRÁCTICA: MANIPULACIÓN DE PCA
- 3. Restos de objetos extraños (FOD)
- Definición y riesgos asociados con los FOD
- Ejemplos de procedimientos para mitigar el daño por FOD
- PRÁCTICA: EJEMPLOS DE FOD
- PRÁCTICA: ESTACIONES DE TRABAJO LIMPIAS
- 4. Procedimientos de la compañía
- Descripción general de los procedimientos relativos a la manipulación de productos y la ESD específicos de la instalación

Prueba de práctica final

Módulo 6: Identificación de componentes

OBJETIVOS

- Identificar los componentes usados en los ensambles electrónicos
- Diferenciar entre alambres, cables y arneses
- Identificar los tipos de terminales que se usan en los ensambles electrónicos
- Identificar diferentes tipos de accesorios de ensamble usados en los ensambles electrónicos

Materiales de instruc<u>ción opcionales </u>

- Ejemplos de componentes de ensamble electrónico comunes, como:
 - Capacitores, resistencias, diodos, transistores, terminales, alambres, cables y accesorios de ensamble para TH y SMT
 - o Componentes axiales, radiales y multiterminal
 - o Alambres, cables, aislamiento y arneses de cables

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

- 1. Componentes de orificios pasantes (TH) y de montaje superficial (SMT)
- Descripción general de los componentes electrónicos de montaje superficial (SMT) y de orificios pasantes (TH)
- Definición de componentes axiales, radiales y multiterminal
- PRÁCTICA: COMPONENTES DE TERMINALES AXIALES Y DE TERMINALES RADIALES
- PRÁCTICA: COMPONENTES MULTITERMINAL
- PRÁCTICA: COMPONENTES SMT
- 2. Componentes activos y pasivos
- Definición y ejemplos de componentes electrónicos activos y pasivos
- PRÁCTICA: COMPONENTES ACTIVOS
- PRÁCTICA: COMPONENTES PASIVOS Y COMPONENTES ACTIVOS
- 3. Polaridad y orientación
- Definición y ejemplos de polaridad y orientación de los componentes electrónicos
- PRÁCTICA: POLARIDAD DE LOS COMPONENTES
- PRÁCTICA: ORIENTACIÓN DE LOS COMPONENTES
- 4. Cables, arneses de cables y terminales
- Descripción general de los alambres y cables
- Descripción de calibre de conductores, aislamiento de conductores y arnés de cables
- Descripción de los tipos de terminales
- PRÁCTICA: ALAMBRES Y CABLES
- PRÁCTICA: CALIBRES DE LOS CONDUCTORES
- <section-header> PRÁCTICA: TERMINALES

5. Accesorios de ensamble

- Descripción general de los tipos y usos de accesorios de ensamble
- Ejemplos de dispositivos de sujeción roscados y no roscados
- PRÁCTICA: DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN ROSCADOS Y NO ROSCADOS
- PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS DE ENSAMBLE
- PRUEBA DE PRÁCTICA FINAL

Módulo 7: Diagramas, especificaciones y medidas

■ OBJETIVOS

- Explicar cómo se usa la lista de materiales (BOM, por sus siglas en inglés) en el proceso de ensamble
- Explicar cómo se usan los diagramas de ensamble en el proceso de ensamble
- Reconocer los símbolos y herramientas de medición que se utilizan en el proceso de ensamble

Materiales de instrucción <u>opcionales</u>

- Copia de documentos comunes utilizados en ensambles electrónicos (según disponibilidad):
 - Lista de materiales (BOM)
 - o Orden de compra (contrato con el cliente)
 - o Diagrama de ensamble
 - o Diagrama de circuito
 - o Archivo de placa Gerber
- Ejemplos de herramientas de medición comunes como reglas, micrómetros, calibres, indicadores pasa-no pasa, aparatos de prueba de tracción y máquinas de medición de coordenadas (CMM)

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

- 1. Diagramas y documentación
- Definición de diagramas y documentos típicos utilizados en ensambles electrónicos
- Descripción de las diferentes partes de una lista de materiales (BOM)
- PRÁCTICA: LISTA DE MATERIALES
- PRÁCTICA: DOCUMENTACIÓN
- 2. Símbolos y herramientas de medición
- Descripción general de los símbolos y sistemas de medición básicos
- Descripción de las herramientas de medición comunes utilizadas en el ensamble electrónico
- PRÁCTICA: SÍMBOLOS DE MEDICIÓN
- PRÁCTICA: HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
- PRUEBA DE PRÁCTICA FINAL

Módulo 8: Principales defectos de PCB y PCA

OBJETIVOS

- Definir el concepto de calidad en la fabricación de productos electrónicos
- Definir las diferentes condiciones de calidad especificadas en las normas IPC-A-610 y IPC-A-600
- Identificar los defectos de las PCB y PCA conforme a las normas IPC
- Usar criterios de condición de calidad para determinar la aceptabilidad de componentes

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN OPCIONALES

- Copia de los estándares IPC-A-600 y IPC-A-610
- Ejemplos de PCA objetivo (ideales) y aceptables
- Ejemplos de PCB con defectos de laminado, revestimiento y/o máscara de soldadura
- Ejemplos de PCA con defectos comunes de soldadura y de componentes

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

SECCIONES

1. Introducción a la inspección y a los defectos

- Descripción general del proceso de inspección electrónica
- Definición de condiciones de calidad dentro del ensamble electrónico
- PRÁCTI<u>CA: DEFINICIÓN DE "CALIDAD"</u>
- PRÁCTICA: CONDI<u>CIONES DE CALIDAD</u>

2. Defectos de las PCB

• Descripción y ejemplos de defectos de laminado, revestimiento y máscara de soldadura

PRÁCTICA: DEFECTOS DE LAS PCB

3. Defectos de los PCA

- Ejemplos de defectos de soldadura
- Ejemplos de defectos por daños en los componentes
- Ejemplos de defectos en la colocación de los componentes
- PRÁCTICA: DEFECTOS DE LA SOLDADURA
- PRÁCTICA: DEFECTOS DE COMPONENTES
- PRÁCTICA: DEFECTOS EN LA COLOCACIÓN DE LOS COMPONENTES

Módulo 9: Normas IPC

■ OBJETIVOS

- Explicar el papel que juegan las normas IPC en la industria electrónica
- Definir el objetivo de las normas IPC más relevantes para los operarios de ensamble
- Distinguir entre los programas de certificación y capacitación

Materiales de instrucción <u>opcionales</u>

- Copia de las normas comunes de IPC, tales como:
 - o IPC-A-600
 - o IPC-A-610
 - o J-STD-001
 - o IPC-7711/7721
 - o IPC-WHMA-A-620

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

SECCIONES

- 1. Las normas IPC y la industria electrónica
- Descripción general del alcance y el propósito del árbol de normas IPC

PRÁCTICA: ÁRBOL DE NORMAS IPC

- 2. Las principales normas IPC para operarios de ensamble
- Descripción de los temas incluidos en IPC-A-600, IPC-A-610, J-STD-001, IPC-7711/7721 y IPC-WHMA-A-620
- Descripción general del proceso de revisión de las normas IPC
- PRÁCTICA: NORMAS COMUNES
- 3. Programas de certificación y de capacitación
- Descripción general de la diferencia entre las certificaciones y los certificados IPC
- Descripción de los exámenes de certificación IPC
- Descripción de los cursos de certificado IPC
- PRÁCTICA: DESARROLLO DE LOS EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN
- PRÁCTICA: PROGRAMAS DE CERTIFICADOS IPC
- PRUEBA DE PRÁCTICA FINAL

Módulo 10: Introducción a la soldadura manual

OBJETIVOS

- Describir el proceso y las propiedades de la soldadura manual
- Explicar el funcionamiento de las herramientas, los equipos y los materiales de uso frecuente en la soldadura manual
- Identificar defectos y anomalías en la soldadura manual

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN OPCIONALES

- Ejemplos de herramientas y equipos de soldadura manual, como:
 - Estación de soldadura
 - Soldador/puntas
 - Alicates de corte/pinzas/pinzas pequeñas
 - Desoldador de bomba de vacío (chupaestaño)
 - o Pistola de aire caliente
 - Microscopio/lupa
- Ejemplos de materiales de soldadura manual, tales como:
 - Pasta de soldadura (estaño-plomo y sin plomo)
 - Alambre de soldadura (estaño-plomo y sin plomo)
 - o Fundente (lápiz/botella)
 - o Limpiador, como el IPA (alcohol isopropílico)
 - Malla para desoldar (trenza de soldadura)
- Ejemplos de defectos comunes de la soldadura manual, como PCB quemadas o daños en componentes y uniones soldadas

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

- 1. Herramientas y materiales de uso frecuente en la soldadura manual
- Descripción general de los instrumentos de soldadura manual como estaciones de soldadura y herramientas manuales
- Propiedades de materiales de soldadura como aleaciones de soldadura, fundente, malla para desoldar (trenza de soldadura) y limpiadores
- PRÁCTICA: SELECCIÓN DE LA PUNTA DEL SOLDADOR
- PRÁCTICA: HERRAMIENTAS DE SOLDADURA MANUAL
- PRÁCTICA: HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE SOLDADURA MANUAL
- 2. Mejores prácticas de la soldadura manual
- Descripción de los procesos básicos de la soldadura manual
- PRÁCTICA: ESTAÑADO
- 3. Defectos de la soldadura manual
- Ejemplos de defectos comunes de PCB y de componentes relacionados con la soldadura manual
- PRÁCTICA: CLASIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS DE SOLDADURA
- PRUEBA DE PRÁCTICA FINAL

Módulo 11: Tecnología de montaje superficial

OBJETIVOS

- Identificar la maquinaria utilizada en el proceso de ensamble con tecnología de montaje superficial (SMT)
- Describir los pasos del proceso de ensamble de placas de circuito impreso (PCB) con tecnología de montaje superficial (SMT)
- Describir el proceso de soldadura por refusión de los ensambles con tecnología de montaje superficial (SMT)
- Identificar los defectos que suelen ocurrir durante el proceso de ensamble con tecnología de montaje superficial (SMT)

Materiales de instrucción opcionales

- Ejemplos de herramientas de ensamble, equipos y materiales de SMT, tales como:
 - o Pasta de soldadura (estaño-plomo y sin plomo)
 - o Lupas
- Prepárese para mostrar a los estudiantes ejemplos de máquinas de proceso de ensamble SMT en sus instalaciones, tales como:
 - Horno de cocción para placas vacías
 - o Impresora de pasta de soldadura
 - o Máquina de recogida y colocación
 - o Horno de refusión
 - o Clavija en pasta
- Ejemplos de defectos comunes de la SMT como los salientes, problemas del pegamento, desprendimiento vertical, desprendimiento horizontal y orientación incorrecta

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

SECCIONES

- 1. Introducción y preparación de la placa de circuito impreso
- Descripción general del proceso de inspección y preparación para PCB de SMT
- 2. Ensamble de PCB con tecnología de montaje superficial
- Descripción general del proceso de ensamble de SMT
- Descripción de la impresión de la pasta de soldadura, colocación de componentes utilizando máquinas de recogida y colocación, y soldadura con un horno de refusión

PRÁCTICA: IMPRESIÓN DE ESTÉNCIL CON PASTA DE SOLDADURA

- 3. Sección 3: Otros procesos usados con tecnología de montaje superficial
- Descripción de cuándo se puede usar la soldadura manual y el pin en pasta dentro del proceso de ensamble de SMT
- 🧐 PRÁCTICA: SOLDADURA INVASIVA (PIN EN PASTA)
- 4. Inspección y defectos de la tecnología de montaje superficial
- Ejemplos de defectos comunes de la SMT: salientes, problemas del pegamento, desprendimiento vertical, desprendimiento horizontal y orientación incorrecta
- PRÁCTICA: DEFECTOS DE LA TECNOLOGÍA DE MONTAJE SUPERFICIAL
- PRUEBA DE PRÁCTICA FINAL

Módulo 12: Tecnología de orificios pasantes

■ OBJETIVOS

- Describir las propiedades de la tecnología de orificios pasantes (TH)
- Describir el proceso de ensamble con la tecnología de orificios pasantes (TH)
- Identificar herramientas, máquinas y métodos de inserción de uso frecuente en el ensamble de placas con componentes de orificios pasantes (TH)
- Identificar los defectos que suelen ocurrir durante el ensamble de placas con componentes de orificios pasantes

Materiales de instrucción opcionales

- Ejemplos de herramientas de ensamble, equipos y materiales de TH, tales como:
 - o Herramientas de preformado de terminales, como bloques y árboles de Navidad
 - o Estación de soldadura
 - o Herramientas de doblado y corte
- Prepárese para mostrar a los estudiantes ejemplos de máquinas de proceso de ensamble TH en sus instalaciones, tales como:
 - o Preformado de terminales semiautomático
 - o Máquina de inserción automática
 - o Máquina de soldadura por ola
 - o Máquina de soldadura selectiva
- Ejemplos de defectos comunes de TH relacionados con la colocación de componentes y la soldadura

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

- 1. Introducción y proceso de ensamble manual con tecnología de orificios pasantes
- Descripción general del proceso de ensamble manual de TH
- Descripción de diferentes procesos de preformado de terminales, instalación de componentes y soldadura manual
- PRÁCTICA: POLARIDAD Y ORIENTACIÓN DE LOS COMPONENTES
- PRÁCTICA: CORTE Y DOBLADO DE TERMINALES
- PRÁCTICA: ¿POR QUÉ SE DEBEN PREFORMAR LOS TERMINALES?
- 2. Proceso de ensamble automático con tecnología de orificios pasantes
- Descripción del proceso automático de preformado, inserción, doblado y corte de terminales
- Descripción general del proceso de soldadura por ola
- 🍳 PRÁCTICA: FASES DE LA SOLDADURA POR OLA
- 🎐 PRÁCTICA: MÁQUINA DE SOLDADURA POR OLA
- PRÁCTICA: MÉTODOS DE SOLDADURA CON TECNOLOGÍA DE ORIFICIOS PASANTES
- 3. <u>Defectos propios del proceso de ensamble con tecnología de orificios pasantes</u>
- Ejemplos de defectos comunes de TH relacionados con la colocación y la soldadura de componentes
- PRÁCTICA: DEFECTOS EN TECNOLOGÍA DE ORIFICIOS PASANTES PARTE 1
- PRÁCTICA: DEFECTOS EN TECNOLOGÍA DE ORIFICIOS PASANTES PARTE 2



Módulo 13: Preparación de alambres y cables

OBJETIVOS

- Identificar las características de los alambres y los cables utilizados en los ensambles electrónicos
- Describir los pasos del proceso de preparación de los alambres y los cables
- Reconocer los criterios de inspección para el corte, pelado y estañado de los alambres

Materiales de instrucción opcionales

- Ejemplos de tipos de alambres y cables como alambres macizos, cables trenzados y cables coaxiales, biaxiales y triaxiales
- Ejemplos de terminales de alambres y cables como los de anillo, de gancho, bifurcado, de desconexión rápida y tipo bala
- Herramientas comunes de preparación de alambres y cables como cortadores, pelacables y crisoles de estañado

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

SECCIONES

- 1. Introducción a los alambres y los cables
- Descripción general de los tipos y propiedades de alambres y cables
- Proceso de medición de alambres y cables
- PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DE LOS ALAMBRES (2 PARTES)
- PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES
- PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CABLES (2 PARTES)
- PRÁCTICA: ALAMBRES, CABLES Y TERMINACIONES (3 PARTES)
- 2. Preparación de los alambres y cables
- Descripción general de las herramientas necesarias para la preparación manual, semiautomática y automática de los alambres y cables
- Descripción de los diferentes métodos de preparación de los alambres y cables
- PRÁCTICA: PREPARACIÓN MANUAL DE LOS ALAMBRES Y CABLES (2 PARTES)
- PRÁCTICA: ESTAÑADO (2 PARTES)
- 3. Inspección de los alambres y cables
- Ejemplos de defectos relacionados con el aislamiento, conductores y estañado de los alambres y cables
- PRÁCTICA: DEFECTOS DEL AISLANTE
- PRÁCTICA: DEFECTOS DE LOS CONDUCTORES
- PRÁCTICA: DEFECTOS DEL ESTAÑADO
- PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS DE LOS ALAMBRES Y CABLES

Módulo 14: Tecnología de alambres y terminales

■ OBJETIVOS

- Identificar los tipos de terminaciones de alambres
- Reconocer los métodos para conectar los alambres a los terminales
- Distinguir entre terminaciones soldadas y crimpadas aceptables y defectuosas

Materiales de instrucción o<u>pcionales</u>

- Ejemplos de terminales comunes como los de torreta, de copa, perforados, bifurcados y de gancho
- Estación de soldadura manual
- Herramientas para el estañado y la limpieza de conexiones soldadas
- Herramientas comunes para el crimpado manual, semiautomático y automático

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

SECCIONES

- 1. Introducción a las terminaciones
- Descripción de los tipos de terminales de alambres y cables soldados y crimpados
- PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE LOS TERMINACIONES

2. Terminaciones soldadas

- Descripción general del proceso de enrutamiento, colocación, soldadura, limpieza e inspección de terminales de alambres y cables
- Ejemplos de defectos relacionados con las terminaciones soldadas
- PRÁCTICA: TERMINACIONES SOLDADAS
- PRÁCTICA: DEFECTOS DE LAS TERMINACIONES SOLDADAS

3. <u>Terminaciones crimpadas</u>

- Descripción general del crimpado manual, semiautomático y automático de terminales de alambres y cables
- Comparación de crimpados de cilindro abierto y de cilindro cerrado
- Ejemplos de defectos relacionados con las terminaciones crimpadas
- PRÁCTICA: CRIMPADO
- PRÁCTICA: INSPECCIÓN DE LAS TERMINACIONES CRIMPADAS

Modulo 15: Tecnología de arnés de cables y alambres

OBJETIVOS

- Identificar los tipos de conectores utilizados en la tecnología de arnés de cables
- Distinguir los métodos de conectorización
- Reconocer los métodos de efectuar y evaluar empalmes de alambres y de cables
- Describir el proceso de ensamble de los arneses de cables

Materiales de <u>instrucción opcionales</u>

- Ejemplos de conectores circulares y rectangulares
- Ejemplos objetivo (ideales) y defectuosos de empalmes soldados, crimpados y soldados por ultrasonidos
- Componentes relacionados con ensambles de arneses de cables, como amarres, terminaciones y etiquetas de identificación
- Copia de la lista de materiales (BOM) relacionada con el ensamble de arneses de cables

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

SECCIONES

- 1. Conectorización
- Descripción general de los componentes y proceso de conectorización
- Comparación de conectores crimpados y soldados
- PRÁCTICA: ESTRUCTURA DEL CONECTOR
- PRÁCTICA: TIPOS DE CONECTORES
- 🏺 PRÁCTICA: CO<u>NECTORIZACIÓN (2 PARTES)</u>

2. Empalme

- Descripción de los tipos de empalmes soldados (de malla, enrollado, de gancho y solapado) y sus defectos
- Descripción de los tipos de empalmes crimpados y sus defectos
- Descripción general del proceso de soldadura por ultrasonidos
- PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS DE EMPALME (2 PARTES)
- PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS DE CRIMPADO
- PRÁCTICA: SOLDADURA POR ULTRASONIDOS
- 3. Ensamble de arneses de cables
- Descripción general de los materiales de ensamble de arneses de cables
- Descripción del proceso de ensamble de arneses de cables
- PRÁCTICA: PROCESO DE ENSAMBLE DE ARNÉS DE CABLES
- PRÁCTICA: ENSAMBLE DE ARNÉS DE CABLES

Módulo 16: Accesorios de ensamble

■ OBJETIVOS

- Identificar las herramientas usadas para ensamblar productos electrónicos
- Reconocer los accesorios y otros materiales usados para ensamblar productos electrónicos
- Diferenciar entre condiciones aceptables y defectuosas de los accesorios de ensamble y los materiales instalados

Materiales de instrucción opcionales

- Copia de la lista de materiales (BOM)
- Herramientas comunes de instalación de accesorios de ensamble como destornilladores, llaves, pinzas, pinzas pequeñas, alicates de corte, portapiezas y prensas
- Accesorios de ensamble comunes como pernos, tornillos y arandelas
- Otros accesorios de ensamble como clips, tuercas insertables (tuercas PEM), espigas roscadas, separadores, espadines, bridas, pines de prueba, pasadores elásticos, remaches, rigidizadores, chapa estampada, placas frontales y manijas
- Ejemplos de materiales disipadores de calor, espaciadores de montaje y ventiladores
- Ejemplos de consumibles de ensamble como fundas, adhesivos y selladores

PRUEBA DE PRÁCTICA P<u>RELIMINAR</u>

SECCIONES

- 1. Introducción y herramientas de ensamble
- Descripción general de las herramientas comunes utilizadas para el ensamble de PCA

🍳 PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

- 2. Materiales y consumibles
- Descripción general de los accesorios de ensamble comunes y los menos típicos
- Descripción de cómo se utilizan las fundas, los adhesivos y los selladores en el proceso de ensamble

PRÁCTICA: MATERIALES DE ENSAMBLE

- 3. Instalación correcta de los accesorios de ensamble
- Descripción de la instalación adecuada de piezas y accesorios dentro de un ensamble
- Definición de espacio eléctrico mínimo (MEC)
- Ejemplos de condiciones objetivo, aceptables y de defecto en el montaje y la aplicación de aislamiento y de compuesto térmico en disipadores térmicos, y la instalación de dispositivos de sujeción roscados
- PRÁCTICA: INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE ENSAMBLE

Módulo 17: Revestimiento de conformación

■ OBJETIVOS

- Identificar los equipos, las herramientas y los materiales usados en el revestimiento de conformación
- Explicar los pasos del proceso de revestimiento de conformación
- Identificar los defectos propios del revestimiento de conformación

Materiales de instrucción <u>opcionales</u>

- Copia de IPC-A-610: Aceptabilidad del ensamble electrónico
- Ejemplos de PCA con y sin aplicación de revestimiento de conformación
- Herramientas comunes de revestimiento de conformación como cepillos, jeringas, pulverizadores, lámparas
 UV y portapiezas
- Materiales de enmascaramiento comunes como cinta, látex líquido y fundas de enmascaramiento
- Equipos de protección individual (EPI) como guantes, gafas de seguridad, delantales y respiradores
- Ejemplos de materiales de revestimiento de conformación (según disponibilidad) como resina acrílica, resina epoxi y resina de silicona
- Herramientas para inspeccionar el revestimiento de conformación como micrómetros, sondas de corrientes de Foucault y cupones de proceso planos
- Prepárese para mostrar a los estudiantes ejemplos de estaciones de revestimiento de conformación dentro de sus instalaciones (según esté disponible), tales como:
 - o Cabina/sala de rociado
 - o Máquina de inmersión automática
 - o Hornos y bastidores de curado
 - o Máquina de deposición de vapor

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

SECCIONES

1. ¿Qué es el revestimiento de conformación?

• Descripción general de la necesidad y el propósito del revestimiento de conformación

PRÁCTICA: PROTECCIONES DEL REVESTIMIENTO DE CONFORMACIÓN

2. Equipos, herramientas y materiales

- Descripción general de los instrumentos utilizados para la aplicación manual del revestimiento de conformación
- Reseña de los diferentes tipos de materiales de revestimiento de conformación y sus respectivos usos y beneficios
- Descripción de cómo se usan las herramientas como la cinta de enmascaramiento, lámparas UV, hornos de curado y portapiezas dentro del proceso de revestimiento de conformación
- PRÁCTICA: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE REVESTIMIENTO DE CONFORMACIÓN
- PRÁCTICA: VESTIMENTA DE SEGURIDAD
- PRÁCTICA: REVESTIMIENTO DE CONFORMACIÓN

3. Proceso de revestimiento de conformación

 Descripción de los principales pasos de los procesos de revestimiento de conformación, como la limpieza, enmascaramiento, aplicación (manual o automática), curado, eliminación del enmascaramiento y extracción del revestimiento de conformación (si es necesario)

- PRÁCTICA: MÉTODOS DE REVESTIMIENTO DE CONFORMACIÓN
- PRÁCTICA: PROCESO DE REVESTIMIENTO DE CONFORMACIÓN
- 4. Inspección y defectos
- Definición de las cualidades aceptables del revestimiento de conformación
- Ejemplos de defectos de revestimiento de conformación como decoloración, burbujas, grietas, cáscara de naranja y FOD
- PRÁCTICA: ANOMALÍAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE CONFORMACIÓN
- PRÁCTICA: COLOCACIÓN DE LOS COMPONENTES ALTURA
- PRUEBA DE PRÁCTICA FINAL

Módulo 18: Encastre a presión

■ OBJETIVOS

- Identificar las herramientas, equipos y materiales usados para insertar componentes de encastre a presión
- Explicar los pasos del proceso de inserción por encastre a presión
- Identificar defectos comunes en la inserción por encastre a presión

Materiales de instrucción <u>opcionales</u>

- Ejemplos de pines de encastre a presión separados de un PCA y dentro de un PCA
- Ejemplos de defectos de encastre a presión como pines doblados y retorcidos, altura incorrecta del pin, anillos perimetrales de PTH levantados y fracturados, y agrietamiento de PCB
- Aparato manual de inserción por encastre a presión
- Máquina automática de inserción por encastre a presión

PRUEBA DE PRÁCTICA PRELIMINAR

- 1. Herramientas, equipos y materiales de encastre a presión
- Descripción general del objetivo y de los tipos de pines de encastre a presión, como pines macizos y dúctiles
- Descripción de los procesos manuales y automáticos de inserción por encastre a presión
- 2. Proceso de encastre a presión
- Descripción de los pasos principales para los procesos de encastre a presión, como fijación del ensamble al portapiezas, colocación de los componentes y aplicación de presión
- PRÁCTICA: FLUJO DEL PROCESO DE ENCASTRE A PRESIÓN
- 3. Inspección del encastre a presión
- Descripción general de las herramientas para la inspección visual y de rayos X de la inserción por encastre a presión
- Ejemplos de defectos del encastre a presión como pines doblados o retorcidos, altura incorrecta del pin, agrietamiento y anillo de PTH perimetral levantado o fracturado
- PRÁCTICA: DEFECTOS DE LOS PINES DE ENCASTRE A PRESIÓN
- PRÁCTICA: DEFECTOS DE LA PLACA CON ENCASTRE A PRESIÓN
- PRUEBA DE PRÁCTICA FINAL